

Ver3.0の主な改善・強化項目

フレームワークソフトの改善強化

□ モデリング機能

- ◆ 櫛歯コマンドの追加: 櫛歯の形状パラメータから立体を作成
- ◆ ミアンダビームの追加: 中心線列・幅・厚さから立体を作成

□ マスクCAD機能

- ◆ マスク領域を示すハッチング線の生成改善
- ◆ 円のマスク領域の作成効率改善

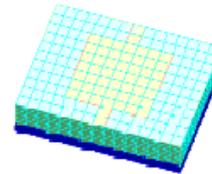
□ 解析条件設定機能

- ◆ 熱ナノのプロセス共通解析条件の一括設定

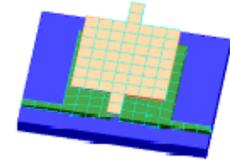
解析機能の改善強化

□ 機構解析部

- ◆ 電界解析における境界要素法の対応



<<有限要素法>>
空気層もメッシュ分割



<<境界要素法>>
デバイス構造のみメッシュ分割

- ◆ Pardiso機能(解析規模の拡大)の導入

データベースの充実

□ 知識DBの充実

- ◆ ファインMEMS知識データ(1700件)の結合
- ◆ ユーザ提供データの挿入

□ 材料DBの充実

- ◆ プロジェクト成果の全データの挿入
- ◆ 不足しているデフォルト値の補強

MEMS回路シミュレータの改善強化

□ MEMS素子の追加

- ◆ 積層梁の追加
- ◆ ユーザ定義GAPモデルの追加

□ GUIの強化

- ◆ 容量・抵抗・電源の配置機能を追加